## h-BN/2 層グラフェン/h-BN ゲートスタック構造での I<sub>on</sub>/I<sub>off</sub> 向上 Improvement of I<sub>on</sub>/I<sub>off</sub> for bilayer graphene by encapsulation with *h*-BN 東大<sup>1</sup>, NIMS<sup>2</sup>, JST-さきがけ<sup>3</sup>, ○ウワンノー ティーラユット<sup>1</sup>, 谷口尚<sup>2</sup>, 渡邊賢司<sup>2</sup>, 長汐晃輔<sup>1,3</sup> Tokyo Univ.<sup>1</sup>, NIMS<sup>2</sup>, PRESTO-JST<sup>3</sup> ○T. Uwanno<sup>1</sup>, T. Taniguchi<sup>2</sup>, K. Watanabe<sup>2</sup> and, K. Nagashio<sup>1,3</sup>

E-mail: uwanno@ncd.t.u-tokyo.ac.jp

1. 緒言 2層グラフェン(BLG)のFET応用の観点から,high-k/BLG/SiO<sub>2</sub>ゲートスタック構造において Ion/Ioff向上を目指した研究が精力的に行われてきた.しかしながら,コンダクタンス法によるギャップ 内準位解析から10<sup>13</sup> cm<sup>-2</sup>eV<sup>-1</sup>もの準位が存在し,さらなるIon/Ioff向上にはデバイス応用においてもh-BN/BLG/h-BNゲートスタック構造の必要性を指摘してきた[1].すでにh-BNとBLGを複層化したデバイ スの報告は数多くあるが,極低温,強磁場下での高移動度・低キャリア数(~10<sup>11</sup>cm<sup>-2</sup>)領域での量子輸送 特性を議論したものが殆どであり,デバイス特性の観点からIon/Ioffを議論した報告は殆ど無い.本研究 では,h-BN/BLG/h-BNデュアルゲートFETのIon/Ioffを評価し,0.3eVのギャップ形成に必要な外部電界の 観点からh-BNの特徴を議論する.

2. *h*-BN/BLG 界面でのバブル形成 PMMA/PDMS/スライドガラス上に*h*-BN を機械的剥離法で転写し, この*h*-BN により n<sup>+</sup>-Si/SiO<sub>2</sub>(90 nm)上の BLG をピックアップした.続けて,*h*-BN/BLG を加熱・冷却機 構を用いた乾式転写手法[2]により別途用意した n<sup>+</sup>-Si/SiO<sub>2</sub>(90 nm)基板上 *h*-BN に対して貼り合わせ,*h*-BN/BLG/*h*-BN ゲートスタックを形成した.大気中での複層化の場合,CH 系の不純物が界面に取り込 まれるバブル形成が知られており,図 1(a, b)に示すように画像処理を施すことで光顕写真においても 黒丸として認識できる.Ar/H<sub>2</sub> 中 300℃,3 時間のアニール後においても凝集せず,清浄界面領域の拡 大は殆ど認められない(図 1(c)).この挙動は自由表面を有する G/*h*-BN 構造と異なり,上側に存在する 数 10nm の *h*-BN によりバブルの移動が妨げられたと考えられる.経験的には,図 1(b)に示すように, 細長い形状のグラフェンを選択して転写することで,バブルの形成を低減することが可能である.

3. 輸送特性及び lon/loff 評価 h-BN/BLG/h-BN 構造において BLG は h-BN に覆われているため、h-BN との化学反応性の強い CF<sub>4</sub> プラズマにより h-BN を選択的エッチングし、EB リソにより Ni/Au 電極を 形成した(図 2 挿入図). チャネル内にバブルを避けることが望ましいが、厳密な制御は困難なためいく つかのバブルを含む形でチャネル領域を定義した. 図 2 に 20K における電子輸送特性を示す. V<sub>BG</sub> 印 加によりギャップが形成し、Dirac point の電気伝導度低下が顕著になる. 図 3 に I<sub>on</sub>/I<sub>off</sub> と Displacement の絶対値[D]の関係を示す. 同じ[D], つまり同じバンド構造において h-BN/BLG/h-BN の I<sub>on</sub>/I<sub>off</sub> は, highk Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/BLG/SiO<sub>2</sub> より高いことから、I<sub>on</sub>/I<sub>off</sub> の向上が確認できる. ここで、TG と BG で同じ絶縁体を用 いた場合、[D] =  $\epsilon V/d$ と簡単化できる. 同一膜厚, 同一電圧下では high-k の方が高い[D]が得られ、0.3eV のギャップ形成に必要な[D]=3V/nm は現時点で high-k のみで達成されており、図中点線で示すように h-BN では 1.2V/nm 程度に留まる[3, 4]. h-BN は、絶縁破壊電界は高いが誘電率が 4 と小さいため、最 大ギャップでの I<sub>on</sub>/I<sub>off</sub> の向上には、トップゲートにおいて h-BN と high-k との複層化が必要となる.

謝辞 本研究の一部は科研費により助成を受けて行われました.ここに深く感謝致します.



[1] K. Kanayama et al. Sci. Rep. 5, (2015) 15789. [2] T. Uwanno, et al. 2D Materials 2, (2015) 041002. [3] A. Varlet, et al., PRL, 113, (2014) 116602. [4] A. F. Young, et al., PR-B, 85, (2012) 235458.

図 1(a), (b) *h*-BN/BLG/*h*-BN の光顕写真. 図 2 電気伝導度とゲート電圧. BN<sub>T</sub>, BN<sub>B</sub>は, それぞれ上側と下側の *h*- (挿入図)複層化デバイスの光顕写真. BN である. (c) 写真(a)におけるアニール



前後のバブル高さと半径の関係.